



“中国材料大会2018” 会议邀请函



尊敬的_____先生/女士():

“中国材料大会2018”定于2018年7月12-16日在福建省厦门市召开,会议由中国材料研究学会发起并主办。分会场和论坛设置如下:

A. 能源材料

- A-01. 能量转换与存储材料(国际分会)
- A-02. 纳米材料与新能源(国际分会)
- A-03. 核材料
- A-04. 太阳能材料与器件
- A-05. 矿物与油气田材料

B. 环境材料

- B-01. 光催化材料
- B-02. 生态环境材料
- B-03. 环境工程材料
- B-04. 资源材料与循环利用

C. 先进结构材料

- C-01. 粉末冶金
- C-02. 高性能铝合金
- C-03. 先进镁合金
- C-04. 高温合金
- C-06. 金属基复合材料
- C-07. 空间材料科学技术
- C-09. 先进陶瓷材料

D. 功能材料

- D-01. 超材料与多功能材料

D-02. 多铁性材料

- D-03. 非晶与高熵合金
- D-04. 极端条件材料与器件
- D-05. 功能分子材料与器件
- D-06. 先进微电子与光电子材料
- D-07. 生物医用材料
- D-08. 纳米多孔金属材料
- D-09. 纤维材料改性与复合技术
- D-10. 高分子材料

E. 材料基础研究

- E-01. 材料先进制备加工技术
- E-02. 材料表征与评价
- E-03. 相分离冶金与材料
- E-04. 先进凝固科学与技术
- E-05. 石油管材及装备材料服役行为与结构安全
- E-06. 材料基因工程
- Z. 材料模拟、计算与设计

F. 论坛

- FA. 两岸三地新材料论坛
- EM. 新材料、新工艺和材料测试技术展览会

注册费标准(不含版面费,会议期间食宿自理):

2018年5月31日前注册交费(以银行印鉴为准):

非学生: RMB 1800元
学 生: RMB 1400元

2018年5月31日后注册交费:

非学生: RMB 2000 元
学 生: RMB 1600 元

付款方式1: 在线支付:请登录会议网站,注册后进行在线支付。

付款方式2: 银行汇款

单位名称: 中国材料研究学会

开户银行: 北京银行魏公村支行

银行帐号: 0109 0303 2001 2011 1009 376

大会诚邀您参加此次会议。

会议注册及提交稿件等详细信息请登录会议网站 www.cmc2018.medmeeting.org。

